



メック株式会社

本社事務所 / 〒660-0881
兵庫県尼崎市昭和通三丁目95番地 アマックスビル
TEL. 06-6414-3451(代) FAX. 06-6414-3455

URL <http://www.mec-co.com/>



再生紙(古紙配合率100%)、大豆油インキを使用しています。



ニュースメール配信サービスのご案内

当社では、ホームページにニュースリリースや新しいコンテンツが掲載された際に、ご登録者のみなさまにそのタイトルとURLを電子メールにてお知らせするサービス(ニュースメール配信サービス)を行っています。

ご希望の株主さまには、こちらのサービスの送信先メールアドレス(携帯電話のメールアドレス不可)を、弊社ホームページまたは、ディア・ネットサービスシステム(<http://www.dirnet.jp/>)から、簡単にご登録いただけます(無料)。

会社案内パンフレットダウンロード・発送のご案内

当社では、事業内容や製品をより多くの方に理解していただくために、ホームページから会社案内パンフレットをダウンロードしていただくことができます。なお、郵送をご希望の方は当社までご連絡いただけますようお願いいたします。



ホームページ
(<http://www.mec-co.com/ir/corporate/>)



会社案内パンフレット



メック株式会社

証券コード：4971

第40期 第2四半期 株主通信

2008年4月1日から2008年9月30日まで

P1 — 株主・投資家のみなさまへ

P5 — 特集1：メックの製品戦略

先端領域で実績を重ね 汎用市場で領域拡大を目指す

P7 — 特集2：メックのグローバル戦略

アジアへの集中投資で 世界中のユーザーに貢献する

P9 — 連結財務諸表

P12 — 会社概要

P13 — 株式の状況

P14 — 株主メモ



株主のみなさまに、 第40期第2四半期の業績および 今後の事業方針についてご報告申し上げます。

Q 当第2四半期の増収・増益要因は？

**民間設備投資の鈍化により
電子基板用機械は低調に推移したものの、
国内及び中国市場で汎用電子基板向けや
高密度電子基板向け薬品が伸張しました。**

当第2四半期連結累計期間における世界経済は、原油価格の高騰や、米国のサブプライムローン問題に端を発する世界金融市場の混乱や株価低迷等により予断を許さない状況となりました。日本経済も同様に、金融不安や株価低迷、原油等の原料価格の高騰、円高の進行等により景気の減速感が強まりました。

電子部品業界においては、低価格パソコンや一部のホームエレクトロニクス分野は堅調に推移したものの、一般的に減速傾向となりました。

このような経済環境のもと、当社グループは電子基板用薬品の新製品開発と汎用電子基板向け薬品の販売拡大に注力しました。新製品開発につきましては、当期中に29件の特許出願を行いました。販売面では、汎用電子基板向けや高密度電子基板向け薬品が伸張した反面、電子基板用機械は顧客の設備投資鈍化により低調に推移いたしました。

その結果、当第2四半期連結累計期間の連結売上高は44億49百万円(前年同期比2.0%増)となりました。販売費及

び一般管理費は人件費増等により17億34百万円となり、同営業利益は9億96百万円(前年同期比1.5%増)、同経常利益は10億33百万円(前年同期比4.7%増)となりました。以上の結果、同四半期純利益は7億79百万円(前年同期比13.0%増)となりました。

Q 製品セグメント別の販売動向は？

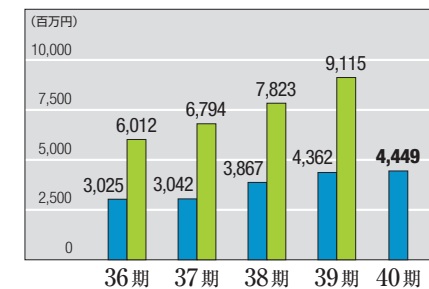
**主力製品のCZシリーズが引き続き伸張するとともに、
汎用電子基板向け薬品の拡販も進みました。**

当社グループの製品セグメントのうち「薬品」の売上は39億89百万円(前年同期比8.6%増)となった一方、顧客の設備投資鈍化により「機械」の売上は1億64百万円と前年同期比62.8%減少しました。

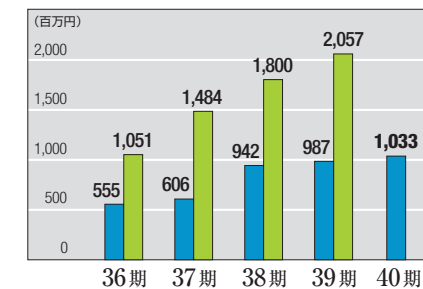
薬品の内訳は、主力製品の超粗化剤CZシリーズの販売が20億50百万円(前年同期比5.5%増)と伸張したことに加え、汎用多層電子基板向けBOシリーズや特殊電子基板向け新製品の販売が拡大したことにより、銅表面処理剤は前年同期比13.3%増の34億3百万円となりました。

連結財務ハイライト

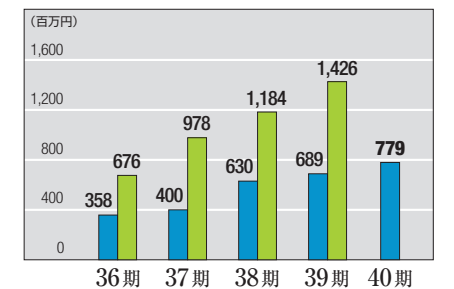
売上高



経常利益

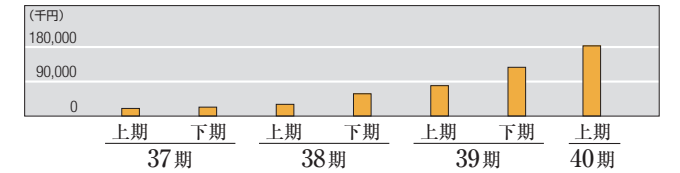


当期純利益



今後、汎用電子基板向け薬品については中国市場を中心に顧客への技術サポートを強化し、さらなる拡販に取り組みます。

BOシリーズ売上高推移



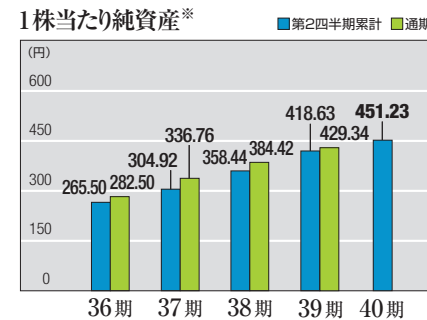
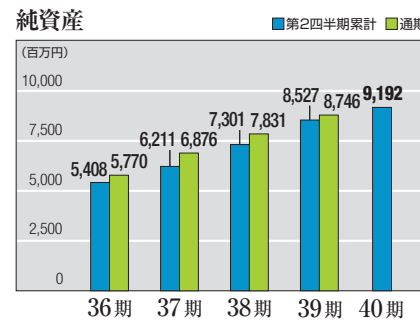
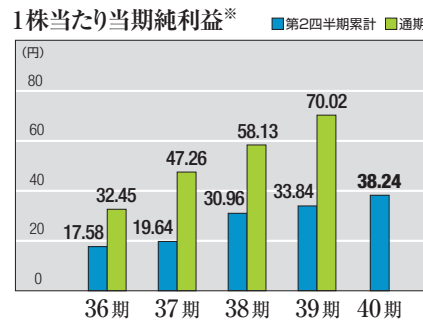
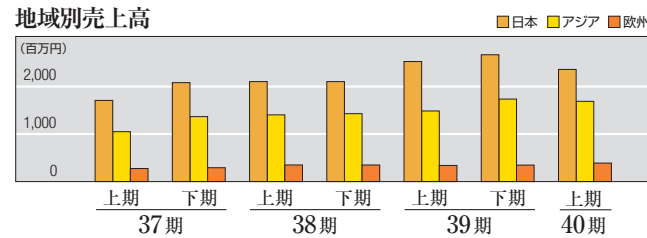
Q 地域別の販売動向は？

**国内は在庫調整等により増収減益。アジアでは中国の
汎用基板市場の拡大で、引き続き増収増益でした。**

国内の電子基板業界においては、一部の高密度電子基板は堅調に推移しましたが、携帯電話やメモリー等の在庫調整により全般的に減速傾向となりました。超粗化剤CZシリーズと新製品の販売が伸張したものの、電子基板用機械は低調となりました。以上の結果、国内の当第2四半期連結累計期間の売上高は23億62百万円(前年同期比6.6%減)、営業利益は5億95百万円(前年同期比-15.1%減)となりました。

アジアでは、パッケージ基板分野以外の韓国勢の稼働率が低く、一方、中国で多層電子基板の生産量が増加したため、薬品販売が増加しました。その結果、第2四半期連結累計期間の売上高は16億88百万円(前年同期比13.3%増)、営業利益は6億49百万円(前年同期比20.9%増)となりました。

欧州では、スペインやフランスの電子基板市場が前期に引き続き縮小しましたが、ドイツ、スイス、オーストリアは比較的好調でした。その結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は3億98百万円(前年同期比16.0%増)、営業利益は37百万円(前年同期比55.5%増)となりました。



* 2004年5月20日および2006年4月1日付でそれぞれ1:2の株式分割を実施しております。上グラフ1株当たり指標については、株式分割がすべて2004年4月1日に実施されたと仮定して遡及修正を行った場合の指標推移を表示しております。

Q 市場動向をふまえたグローバル戦略は?

世界的な低価格モバイル電子機器の需要拡大のなかで、最適化した製品の開発にも注力していきます。

世界の電子機器市場で当面伸びが期待できる製品分野は、低価格パソコン・携帯電話・車載用電子機器です。これら製品は、普及率が低い発展途上国で需要が高まっています。中でも低価格パソコンは、日本をはじめ先進国でもセカンドユースや、個人用として需要があります。今後は同価格帯の携帯電話との競争もあり、こうした市場は世界的に拡大するでしょう。

これを当社は業績拡大の好機ととらえています。当社薬品の市場である、これら電子機器に搭載される汎用電子基板およびパッケージ基板の需要も拡大するからです。

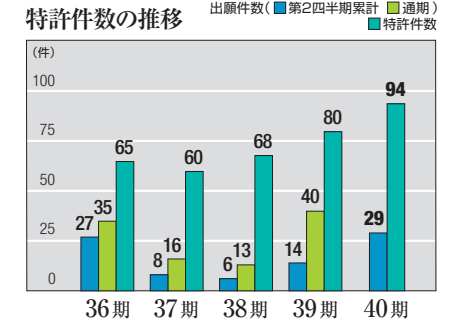
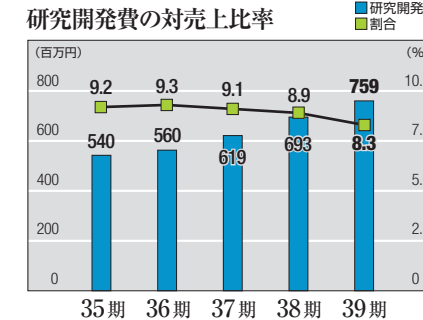
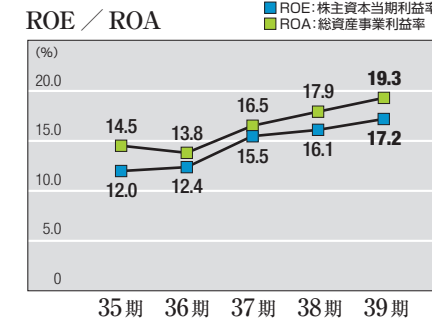
近年、世界の汎用基板メーカーは生産拠点を、中国を中心とする東アジアに移行しており、この傾向は今後も続くと考えており、台湾新工場に続き操業を開始した中国(蘇州市)の最新鋭工場により需要拡大に対応しています。また、引き続きアジア市場向けに最適化した製品の開発にも注力してまいります。

Q 研究開発の方針と進捗は?

最先端プロセスの次世代製品開発に取り組むとともに、引き続き環境対応製品に注力します。

当社の成長力の源泉となってきた高密度基板市場では、半導体の微細化に伴い、銅の配線パターンがさらに高精細化し、銅と樹脂との密着強度がさらに重要になっていきます。当社の超粗化剤CZシリーズでも対応できなくなる時代を見越して、数年前から次世代製品の開発を進めています。

目下の重点テーマは、環境対応薬品の開発です。近年の汎用基板市場では、はんだ部分の鉛フリー化や基板材料のハロゲンフリー化に対応した薬品の需要が高まり、製造工程で使用する薬品も見直しが求められています。このため当社の環境対応製品VボンドやCLシリーズの採用が進んでいます。こうした環境対応分野で当社の優位性を発揮していくため、今後とも新製品開発に注力する方針です。現在、基板製造時における使用電力や水の低減が可能となる薬品の開発も進めています。



Q 今後の事業方針は?

金融危機の波及状況を見極めながら、需要の動向把握とグループ各社との連携強化に努めます。

金融危機の波及状況を見極めながら、需要の動向把握とグループ各社との連携強化に努めます。

米国発の金融危機の深刻化で、金融市場の動揺が実体経済に波及しています。世界経済の減速懸念が強まる中、今後ますます厳しい事業環境になることが予想されます。アジアは台湾を中心として回復傾向を示していましたが、この金融不安が今後どのような影響を与えるか、これからも注意深く見極めていく必要があります。

当社としましては、そのうえで今後とも製品需要の動向把握に努め、海外においてはグループ各社との営業・技術・生産各分野での連携をさらに深め、グループ拡販体制の強化を図ってまいります。

株主の皆様には今後とも一層のご理解、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長 **前田 和夫**

先端領域で実績を重ね、汎用市場で領域 拡大を目指す

高密度電子基板の信頼性向上に欠かせない メックの技術

エレクトロニクス製品の小型化・高性能化に伴い、電子部品を搭載するパッケージ基板の多層化・高精細化が進んでいます。こうした電子基板上に精密な回路パターンを形成する上で、当社の表面処理薬品が欠かせなくなっています。

なかでも当社主力製品の「メックエッチボンドCZ」シリーズは、基板上の銅表面に微細な凹凸を形成することにより樹脂との密着強度を飛躍的に高め、基板製造工程の信頼性向上に貢献しています。当社は、こうした難易度が高い先端プロセスの製品開発で技術ノウハウを蓄積。他社の追随を許さない市場占有率を獲得してきました。

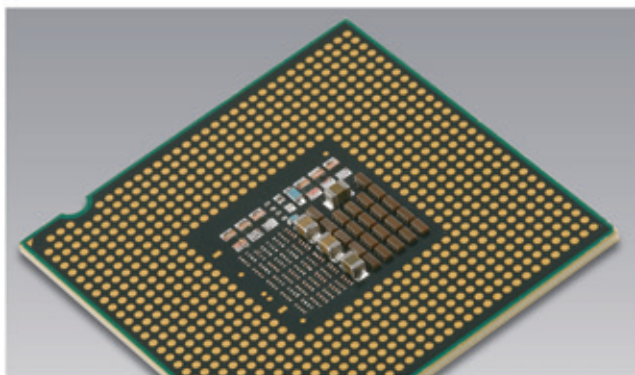
低価格モバイル電子機器の需要増大で さらなる販売拡大

当社ではこうした先端プロセスに向けた製品開発で培った技術を、薄型テレビや携帯電話、車載向け電子機器など、より需要が大きい汎用基板市場にも応用し、領域拡大を進めています。

特に最近、高い価格性能比を備えた低価格パソコンが売れ筋。もともとはパソコンの普及率の低い地域用に開発されたモデルですが、手軽に購入できるセカンドユース機として日本をはじめ先進国でも人気を集めており、世界的に需要が拡大しています。これらには汎用基板だけでなく高密度パッケージ基板も使用されるため、当社が販売拡大を目指す上で絶好の市場なのです。

パッケージ基板

パソコンのMPUやゲーム機用の最先端半導体を搭載する高密度電子基板。高精細な回路パターンを形成するために、当社のCZシリーズがその製造工程に欠かせない薬品になっています。

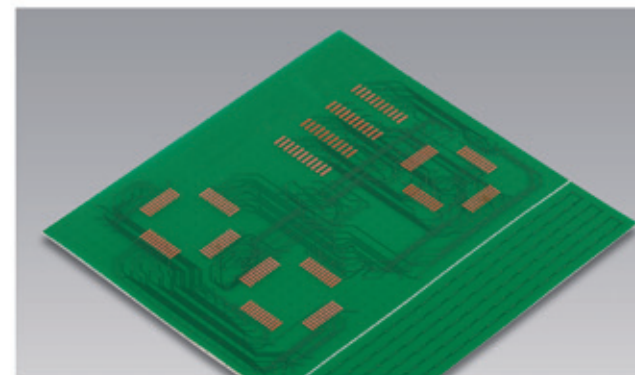


今後の動向

最近の低価格パソコンのCPUとして、インテルのAtom(アトム)搭載が進んでおり、その製造工程でCZシリーズが採用されています。次世代半導体では、回路線幅が45ナノメートル以下になる予定で、それに合わせてパッケージ基板もさらに高密度化が進んでいます。銅と樹脂との密着強度がさらに重要になるため、これに対応したCZシリーズの次世代製品の開発を進めています。

汎用基板

デジタルカメラや携帯電話、車載用機器などに使用される多層電子基板。当社では細線パターン形成の前処理に使うエッチダウン剤や、熱対策に優れた黒化処理代替剤BOシリーズを提供しています。

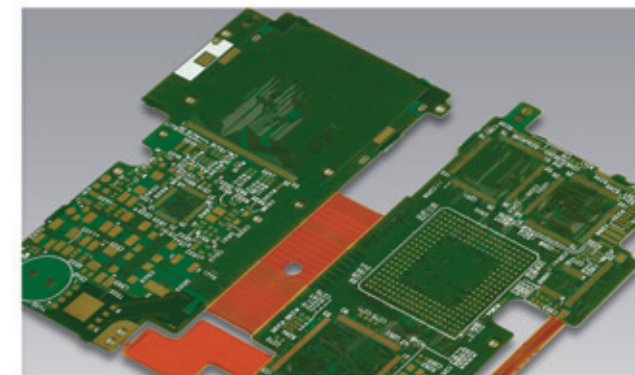


今後の動向

BOシリーズは、ハロゲンフリー材と銅の密着性を高める環境対応製品ということもあり、国内および中国市場を中心に販売が拡大しています。製品分野別では薄型テレビや車載向け、HDD向け基板の製造工程で使用される薬品が特に伸びており、世界の生産拠点である中国市場を中心に拡販が見込まれています。

ポリイミド基板

耐熱性や耐薬品性にすぐれたポリイミド樹脂をベース材とした屈曲可能な電子基板。携帯電話や薄型テレビ等に使われています。当社では同基板向けに高密度化を実現するCHシリーズを提供しています。



今後の動向

ポリイミド基板は、HDD向けに採用されたのをはじめ、近年では携帯電話、デジカメ、液晶などが需要の牽引役となってきました。高精細化する液晶テレビなど映像機器分野において欠かせない基板であり、さらなる拡大が期待される市場となっています。とくに国内では2011年のアナログ放送停止による、地上デジタル放送対応テレビへの買い換え需要に期待が持たれています。

アジアへの集中投資で、世界中のユーザーに貢献する

引き続き中国への生産集中。 華北・華中市場向けの生産能力増強を完了

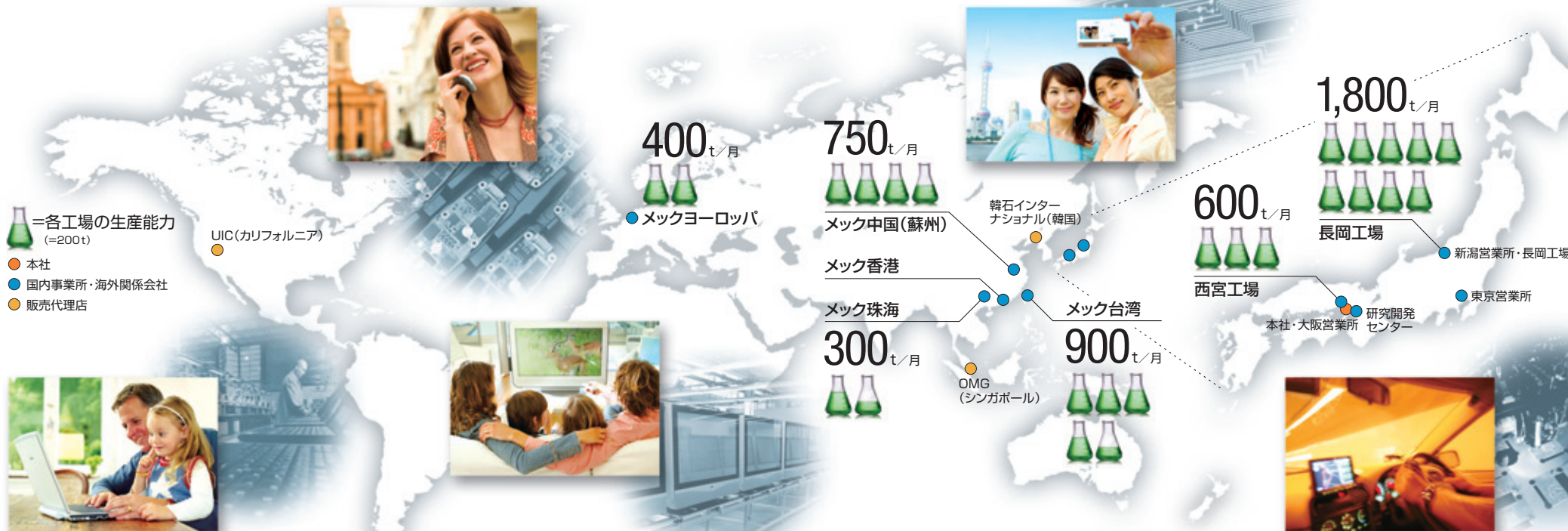
パソコンや携帯電話、デジタル家電などの電子機器を世界市場へ供給するための生産拠点として、中国への生産集中度が高まり、汎用電子基板の生産移行が続いています。

当社グループの中国における基本戦略は、国内で確立した新製品の実績をもとに、現地の日系企業に製品供給し、さらには台湾系、欧米系企業へと水平展開を図っていくこと。そのための重要拠点としてメック中国(蘇州)の生産拠点を移転・拡張し、操業を開始しました。今後も中国および台湾で生産体制の刷新・拡充をはかり、売上増を目指していきます。

インドやタイ、ベトナムなど アジアの新興市場に向けた布石

世界的な経済状況の悪化から、電子機器分野においても当面景気後退が予想されますが、中期的に見れば、中国が世界最大規模の市場であることは今後しばらくは変わらないと予想されます。

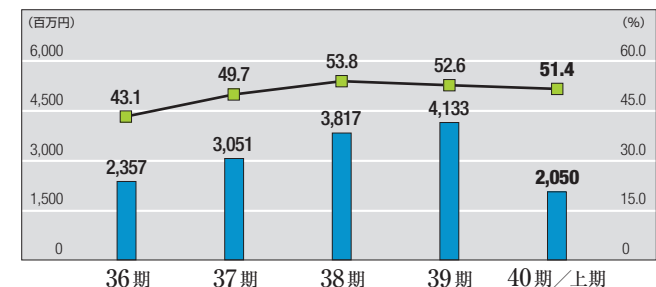
加えて近年立ち上がってきた、インド、ベトナム、タイなどの新興市場の成長が予測され、当社顧客もこれら地域に拠点を展開しています。当社はこれらの地域についても、販売代理店への技術支援や外部組織を活用するなど、厚い支援体制を敷いています。今後はこれら新興市場への拠点開設も視野に入れた活動を続けていきます。



ますます高まる電子機器の 中国への生産集中度

中国における薄型TV、パソコン、携帯電話、デジタル家電やそれらの部品ユニット・モジュールなどの生産動向は、台湾企業を中心に欧米、日本、韓国の企業が世界市場に供給するために中国を生産拠点としており、中国への生産集中はますます高まっています。外資企業の対中投資は、これまで主に中国の安い生産コストを目的としたものでしたが、近年は中国内需市場開拓を最重要戦略に位置づける企業が多くなっています。

薬品売上高に占めるCZシリーズの割合



パッケージ基板向けCZシリーズは 今後とも世界的な需要拡大傾向に

半導体パッケージ基板は、ICやLSI等をほこりや水分、衝撃などから保護し、電気接続を行う重要な部品。パソコンや携帯電話、デジカメ、薄型テレビなどの高性能化が進むなか、その需要はますます増大しています。1995年に発売を開始した当社のCZシリーズは、こうした高密度・高性能電子基板の製造に欠かせない銅表面処理剤として現在、世界中で使用されています。今後も引き続き販売拡大が続くと予測しています。

連結貸借対照表(要約)

(単位:千円)

	当第2四半期 連結会計期間末 2008年9月30日	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 2008年3月31日
(資産の部)		
流動資産	7,399,172	7,046,582
現金及び預金	4,105,650	3,667,056
1 受取手形及び売掛金	2,440,130	2,654,855
有価証券	50,000	50,000
2 商品及び製品	337,318	245,230
3 原材料及び貯蔵品	307,453	251,024
繰延税金資産	111,307	125,916
その他	68,455	66,793
貸倒引当金	△21,143	△14,295
固定資産	4,441,948	4,532,123
有形固定資産	3,726,878	3,545,615
4 建物及び構築物	1,559,244	1,338,124
機械装置及び運搬具	431,781	439,062
工具、器具及び備品	189,022	200,822
土地	1,286,063	1,286,750
建設仮勘定	260,767	280,856
無形固定資産	68,314	78,461
のれん	17,542	20,872
その他	50,772	57,589
投資その他の資産	646,755	908,046
5 投資有価証券	503,403	656,440
6 その他	168,170	261,277
貸倒引当金	△24,817	△9,672
資産合計	11,841,121	11,578,706

連結貸借対照表(要約)

(単位:千円)

	当第2四半期 連結会計期間末 2008年9月30日	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 2008年3月31日
(負債の部)		
流動負債	2,301,846	2,451,345
支払手形及び買掛金	969,549	999,500
短期借入金	480,000	480,000
7 未払金	219,998	332,821
未払費用	37,157	85,778
未払法人税等	290,372	298,856
賞与引当金	194,690	154,752
役員賞与引当金	9,450	—
その他	100,626	99,636
固定負債	347,036	381,193
8 繰延税金負債	227,177	270,936
その他	119,859	110,256
負債合計	2,648,882	2,832,538
(純資産の部)		
株主資本	9,119,392	8,544,011
資本金	594,142	594,142
資本剰余金	446,358	446,358
利益剰余金	8,078,938	7,503,558
自己株式	△47	△47
評価・換算差額等	72,846	202,156
9 その他有価証券評価差額金	△2,088	94,013
為替換算調整勘定	74,936	108,143
純資産合計	9,192,238	8,746,167
負債純資産合計	11,841,121	11,578,706

連結損益計算書(累計期間)(要約)

(単位:千円)

	当第2四半期連結累計期間 2008年4月1日現在から 2008年9月30日現在まで	前中間連結会計期間* 2007年4月1日現在から 2007年9月30日現在まで
10 売上高	4,449,020	4,362,392
売上原価	1,717,621	1,753,536
11 売上総利益	2,731,398	2,608,856
12 販売費及び一般管理費	1,734,443	1,626,773
13 営業利益	996,955	982,082
営業外収益	50,477	28,961
受取利息	20,721	12,719
14 受取配当金	8,158	2,992
15 為替差益	8,798	—
設備賃貸料	6,212	6,074
その他	6,586	7,175
営業外費用	13,664	23,891
支払利息	3,344	3,837
設備賃貸費用	1,827	5,407
16 為替差損	—	8,544
その他	8,492	6,102
17 経常利益	1,033,767	987,153
特別利益	101,356	2,245
固定資産売却益	447	2,245
18 保険解約返戻金	100,909	—
特別損失	15,437	1,390
固定資産売却損	55	—
固定資産除却損	3,275	1,390
19 減損損失	12,106	—
税金等調整前四半期純利益	1,119,686	988,007
20 法人税等	340,591	298,679
21 四半期純利益	779,094	689,328

※ 前年同四半期の中間連結損益計算書を基にしておりますため、区分名が異なる場合があります。

POINT **1** 受取手形及び売掛金：前期機械売上債権の回収による減少(日本)。POINT **2** 商品及び製品：オリンピック対応(輸送規制)による増加(中国)。POINT **3** 原材料及び貯蔵品：原材料値上げ対応のまとめ買いによる増加(日本)。POINT **4** 建物及び構築物：メック中国(蘇州)の新工場完成による増加。POINT **5** 投資有価証券：株式の時価下落による減少。POINT **6** その他：主に保険積立金の満期に伴う減少。POINT **7** 未払金：「設備関係未払金」(日本)の減少など。POINT **8** 繰延税金負債：株式の時価下落による減少。POINT **9** その他有価証券評価差額金：株式の時価下落による減少。POINT **10** 売上高：前年同期と比べ86百万円(2.0%)の増収。
薬品売上は3,989百万円となり前年同期より314百万円(8.6%)の増加。機械は278百万円の減少。資材は42百万円の増加。POINT **11** 売上総利益：売上(薬品売上)の増加により売上総利益も増加。
前年同期と比べ122百万円(4.7%)の増加。
売上総利益率が上昇しているのは、薬品売上の増加によるもの。POINT **12** 販売費及び一般管理費：前年同期より107百万円(6.6%)の増加。主に日本での人件費、研究開発費、旅費交通費などが主要因。POINT **13** 営業利益：前年同期に比べ14百万円(1.5%)の増益。POINT **14** 受取配当金：前期新規取得株式の配当による増加。POINT **15** 為替差益：前年同期は為替差損。POINT **16** 為替差損：当期は為替差益。POINT **17** 経常利益：前年同期より46百万円(4.7%)の増益。POINT **18** 保険解約返戻金：保険満期による返戻金。POINT **19** 減損損失：メック中国(蘇州)旧工場の機械装置などの減損によるもの。POINT **20** 法人税等：簡便法をもとに試験研究費に係る法人税額の特別控除を加味して算出(日本)。POINT **21** 四半期純利益：前年同期と比べ89百万円(13.0%)の増益。

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

	当第2四半期連結累計期間 2008年4月1日現在から 2008年9月30日現在まで	前中間連結会計期間* 2007年4月1日現在から 2007年9月30日現在まで
22 営業活動によるキャッシュ・フロー	881,457	578,433
税金等調整前四半期純利益	1,119,686	988,007
減価償却費	179,696	140,243
減損損失	12,106	—
貸倒引当金の増減額(△は減少)	22,082	2,444
賞与引当金の増減額(△は減少)	39,938	16,806
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	9,450	△10,405
受取利息及び受取配当金	△28,879	△15,711
保険解約返戻金	△100,909	—
支払利息	3,344	3,837
売上債権の増減額(△は増加)	198,816	△307,512
たな卸資産の増減額(△は増加)	△155,031	△22,185
仕入債務の増減額(△は減少)	17,781	146,126
その他	△143,294	△35,821
小計	1,174,789	905,830
利息及び配当金の受取額	29,083	15,635
利息の支払額	△3,194	△4,097
法人税等の支払額	△319,220	△338,934

POINT 22 営業活動によるキャッシュ・フロー:

営業活動の結果、得られた資金は8億81百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が11億19百万円あったこと、売上債権の減少が1億98百万円あったこと等により資金の増加に貢献したものの、資金の減少要因としてたな卸資産の増加が1億55百万円、法人税等の支払いが3億19百万円あったこと等により、資金の増加が一部相殺されたことによるものであります。

(単位:千円)

	当第2四半期連結累計期間 2008年4月1日現在から 2008年9月30日現在まで	前中間連結会計期間* 2008年4月1日現在から 2008年9月30日現在まで
23 投資活動によるキャッシュ・フロー	△526,972	△1,007,150
定期預金の預入による支出	△1,012,361	△815,129
定期預金の払戻による収入	726,887	547,826
有形固定資産の取得による支出	△427,401	△435,914
有形固定資産の売却による収入	2,520	3,971
無形固定資産の取得による支出	△1,440	—
投資有価証券の取得による支出	△10,160	△309,403
投資有価証券の売却による収入	1,127	—
保険積立金の解約による収入	214,394	—
長期前払費用の取得による支出	△21,503	—
その他	965	1,498
24 財務活動によるキャッシュ・フロー	△202,714	△177,862
短期借入れによる収入	130,000	30,000
短期借入金の返済による支出	△130,000	△30,000
配当金の支払額	△202,714	△181,696
その他	—	3,834
現金及び現金同等物に係る換算差額	7,061	40,403
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	158,832	△566,175
現金及び現金同等物の期首残高	2,792,447	3,033,255
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,951,279	2,467,080

POINT 23 投資活動によるキャッシュ・フロー:

投資活動の結果、使用した資金は5億26百万円となりました。これは主に定期預金の預入が純額で2億85百万円あったこと、有形固定資産の取得による支出が4億27百万円あったものの、保険積立金の解約による収入が2億14百万円あったこと等によるものであります。

POINT 24 財務活動によるキャッシュ・フロー:

財務活動の結果、使用した資金は2億2百万円となりました。これは配当金の支払が2億2百万円あったことによるものであります。

* 前年同四半期の中間連結キャッシュ・フローを基にしておりますため、区分名が異なる場合があります。

会社概要

会社概要

2008年9月30日現在

商号	メック株式会社
本社事務所所在地	兵庫県尼崎市昭和通三丁目95番地 アマックスビル
設立年月日	1969年(昭和44年)5月1日
資本金	594,142,400円
事業内容	電子基板製造用薬品、機械装置及び 各種資材の製造販売

役員

2008年9月30日現在

代表取締役社長	前田和夫
取締役兼専務執行役員	内野登一
取締役兼常務執行役員	溝口芳朗
取締役	岩倉襄
執行役員	神田寛明 三田明郎 松下太伸 北村登志子 中川英敏 成田英真 長井真
監査役(常勤)	藤山正人
監査役	関川正之 八田伸



● 国内事業所
● 海外関係会社

国内事業所

2008年9月30日現在

本社/大阪営業所
兵庫県尼崎市昭和通三丁目95番地 アマックスビル
TEL. 06-6414-3451(代) FAX. 06-6414-3455

東京営業所
東京都立川市栄町六丁目1番1号 立飛ビル7号館7階
TEL. 042-538-1080(代) FAX. 042-538-1090

新潟営業所/長岡工場
新潟県長岡市西陵町221番地36
TEL. 0258-47-2490(代)
FAX. 0258-47-2492(営業所) 0258-47-2493(生産)

西宮工場
兵庫県西宮市鳴尾浜二丁目1番19号
TEL. 0798-46-8588(代) FAX. 0798-46-8688

研究所
兵庫県尼崎市東初島町1番地
TEL. 06-6401-8170(代) FAX. 06-6401-8172

海外関係会社

2008年9月30日現在

MEC TAIWAN COMPANY LTD.
No.3, Ziqiang 6th Rd., Zhongli City, Taoyuan County 320,
Taiwan (R.O.C)
TEL. 886-3-434-3549 FAX. 886-3-434-5047

MEC EUROPE N.V.
Kaleweg 24-26, B-9030 Gent, Belgium
TEL. 32-9-216-7272 FAX. 32-9-216-7270

MEC (HONG KONG) LTD.
No.8, 12/F., Tower 3 China Hong Kong City, 33 Canton Road,
Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
TEL. 852-2690-2255 FAX. 852-2690-2262

MEC FINE CHEMICAL (ZHUHAI) LTD.
530 An Ji East Road, Sanzao Town, Jinwan Qu,
Zhuhai City, Guang Dong, China
TEL. 86-756-762-2328 FAX. 86-756-762-2628

MEC CHINA SPECIALTY PRODUCTS (SUZHOU) COMPANY LTD.
31 Linjiang Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu
215121, China
TEL. 86-512-6745-1990 FAX. 86-512-6745-1993

株式の状況

株主状況

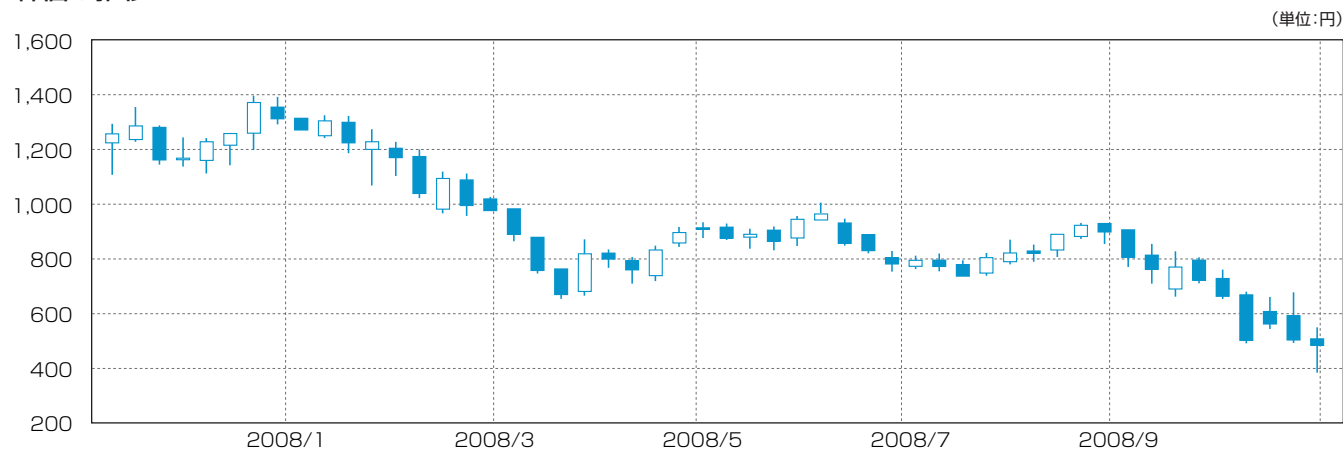
2008年9月30日現在

発行済株式総数 20,371,392株
株主数 3,272名

大株主

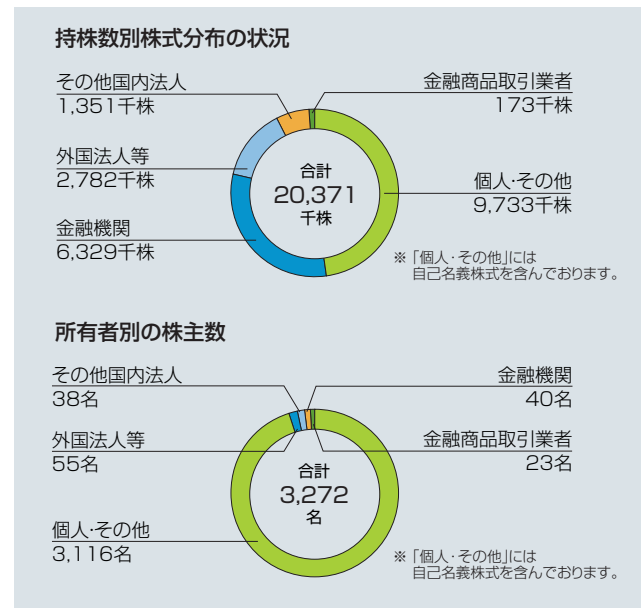
株主名	当社への出資状況	
	所有株数(千株)	持株比率(%)
日本トラスティサービス信託銀行株式会社(信託口)	2,083	10.22
前田 耕作	1,335	6.55
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	1,042	5.11
日本トラスティサービス信託銀行株式会社(信託口4G)	989	4.85
ゴールドマンサックスアンドカンパニーレギュラーアカウント	920	4.51
川邊 豊	818	4.01
有限会社ケイ・エム・ビジネス	800	3.92
小林 義雄	785	3.85
×ロソクエヌエートリーティアクライアントオムニバス	785	3.85
前田 和夫	659	3.23

株価の推移



株式分布状況

2008年9月30日現在



株主メモ

事業年度 4月1日から翌年3月31日まで
 期末配当金受領株主確定日 3月31日
 中間配当金受領株主確定日 9月30日
 定時株主総会 毎年6月
 1単元の株式数 100株
 株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社
 同事務取扱場所 三菱UFJ信託銀行株式会社
 大阪証券代行部

〒530-0004
 大阪市北区島島浜一丁目1番5号
 TEL. 0120-094-777(通話料無料)
 同 取 次 所 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国本支店
 (下記ご注意ください)

【株式に関するお手続き用紙のご請求について】

株式に関するお手続き用紙(届出住所等の変更届、配当金振込指定書、単元未満株式買取請求書等)のご請求につきましては、以下のお電話およびインターネットにより24時間受け付けておりますので、ご利用ください。なお、株式電子化実施後は、特別口座に記録された株式についてのお手続き用紙のみとなりますので、ご注意ください。

TEL. 0120-244-479(証券代行部)
 0120-684-479(大阪証券代行部)

インターネットアドレス <http://www.tr.mufg.jp/daikou/>

上 場 証 券 取 引 所 東京証券取引所市場第一部
 大阪証券取引所ヘラクレス
 証 券 コ ー ド 4971
 公 告 の 方 法 日本経済新聞に公告いたします。

平成21年1月5日施行の株券電子化実施に伴うお知らせ

株券電子化前後における単元未満株式買取請求について

株券電子化の前後においては、単元未満株式買取請求につきましては、以下のとおりとなりますので、ご注意ください。

(1) 証券保管振替制度をご利用でない単元未満株式

平成21年1月5日(月)から平成21年1月25日(日)までは、受付をいたしません。

また、平成20年12月25日(木)から12月30日(火)までのご請求受付分につきましては、買取価格はご請求受付日の終値を適用いたしますが、買取代金のお支払いを平成21年1月30日(金)とさせていただきます。

(2) 証券保管振替制度をご利用の単元未満株式

株券電子化実施の前後において、一定期間お取引の証券会社で取次ぎを行わないと承っております。

具体的な日程につきましては、証券会社により異なることが考えられますので、お取引の証券会社にお問い合わせください。

アンケートのお願い

当社では、株主の皆さまとのよりよいコミュニケーションを目指し、今後も業績情報の開示の充実に努めてまいりたいと考えております。

つきましては、この株主通信に対するご意見、ご感想をお聞かせいただきたくアンケートにご協力をお願いいたします。

同封のアンケートハガキにご記入いただき、ご投函いただけますようお願いいたします。

今後とも、ご指導ご鞭撻よろしくお願い申し上げます。